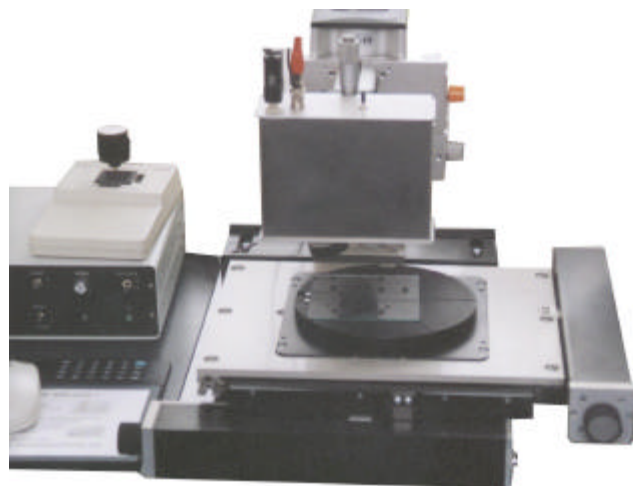


Dickenmessgerät FLATSCAN WMT für Wafer Mounting Technologie

Berührungslose Dickenmessung von Substrat und Kittschicht

FLATSCAN WMT ermöglicht hochgenaue, berührungslose Dickenmessungen für alle Arten transparenter Objekte. In der Wafer Mounting Technologie misst FLATSCAN WMT die gemeinsame Dicke des Substrates und der Kittschicht.



Hochauflösender optischer Dickensensor garantiert exakte Messungen



Basis des Messgerätes ist ein optischer Dickensensor. Er

ermöglicht die direkte Messung der Dicke transparenter Objekte nach einmaliger Kalibrierung mit hoher Reproduzierbarkeit. Die Probe wird mittels eines schrittmotorgetriebenen x/y-Tisch positioniert. Die Steuerung des Tisches erfolgt wahlweise mittels Joystick oder per Software.

Komfortable Windows-Software ermöglicht wahlweise Einzelmessungen oder automatische Dickenmappings

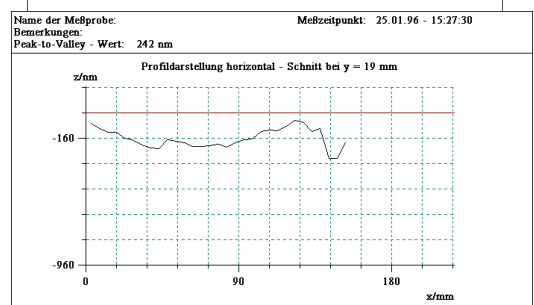
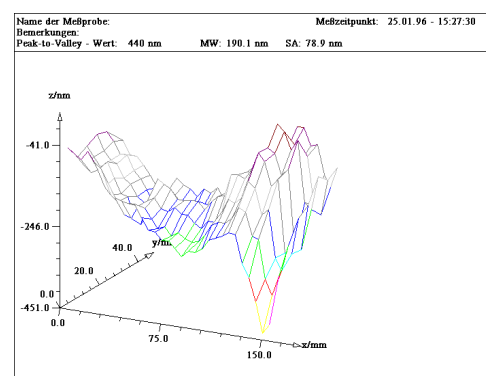
Eine komfortable Windows-Software steuert den Messablauf und bietet zahlreiche Möglichkeiten für die grafische und numerische Datenauswertung. Sie ermöglicht die 3D-Darstellung der Dickenverteilung und Schnittdarstellungen.

Die Messwerte können in frei konfigurierbaren Messprotokollen oder in ASCII-Files gespeichert werden.

Das Standard-Messfeld beträgt (150 x 150)mm. Beliebige andere Messfelder sind möglich.

Technischen Daten

Positioniergenauigkeit:	10 µm
Messgenauigkeit:	± 1 µm
Messfeld:	(150 x 150) mm
Freier Arbeitsabstand:	22 ± 5 mm
Messwellenlänge:	670 nm



Software: 32 Bit, lauffähig unter
Windows95/98/NT/2000